

SEDEX 2025 REVIEW

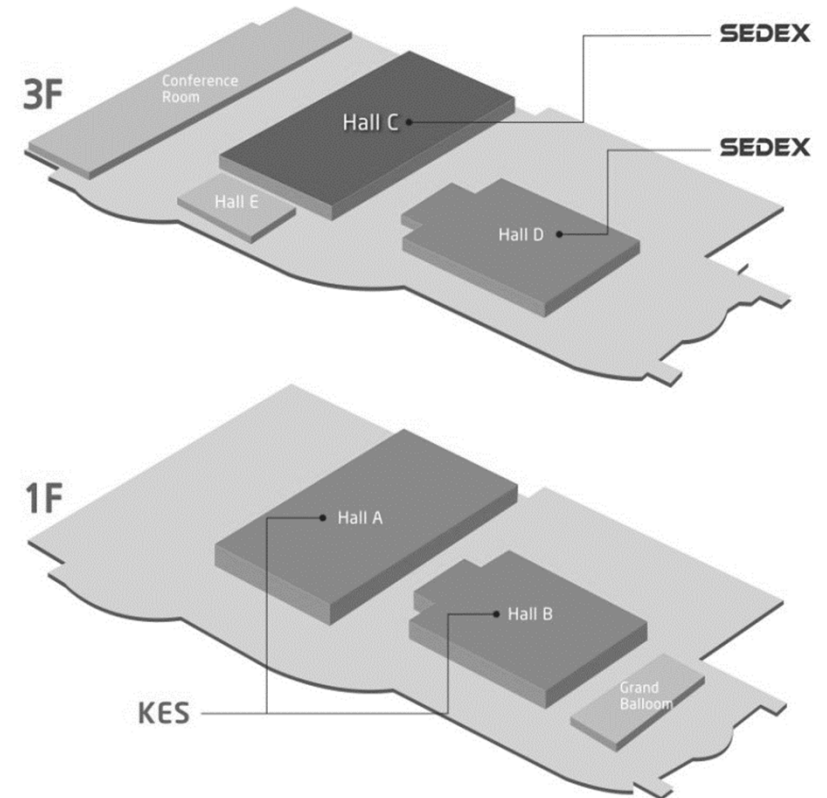
2025.11

[반도체 전문 종합 전시회 SEDEX 2025]

- ✓ 국내 반도체 산업계 최대 행사인 반도체 대전 'SEDEX 2025'가 사흘간의 일정을 마치고 폐막했다. 올해 반도체 대전은 국내 반도체 생태계를 이루는 230여 개사가 650여 부스 규모로 참여했으며 설계부터 소재·부품·장비(소부장)에 이르는 전(全) 분야 최신 기술과 산업 동향을 한 자리에서 확인할 수 있었다.
- ✓ 올해 전시회의 주제인 'Beyond Limits, Connected Innovation(한계를 넘어, 연결된 혁신)'은 AI 시대에 반도체 산업이 나아갈 두 가지 핵심 전략을 명확히 보여준다. 하나는 기존 기술의 물리적 '한계'를 돌파하는 것이며, 다른 하나는 생태계 전체를 유기적으로 '연결'하여 혁신을 가속화하는 것이다. 특히 올해는 기술의 한계에 도전하는 메모리 반도체를 넘어 '설계-제조-후공정'의 유기적인 연결, 즉 대한민국 반도체 생태계의 완성된 모습을 선보이는 데 초점이 맞춰졌다
- ✓ 삼성전자는 AI 인프라 혁신을 이끄는 고대역폭 DRAM과 고성능 스토리지 등 최첨단 메모리 솔루션은 물론, 모바일·IoT·오토모티브 등 일상 경험을 도약시킬 고성능 프로세서, 통신 칩, 이미지 센서, 그리고 고객 맞춤형 파운드리 서비스까지 총망라한 포트폴리오를 선보였다.
- ✓ SK하이닉스는 AI 메모리 성능의 한계를 뛰어넘은 HBM4와 저전력·고성능 LPDDR6 등 세계 최고 수준의 차세대 메모리 솔루션을 공개한다.

1. SEDEX 2025 Overview

- ▶ 행사 : SEDEX 2025 (제 27회 반도체대전)
- ▶ 장소 : COEX Hall C&D1 (3F)
* KES(한국전자전) 2025 : Hall A&B (1F)
- ▶ 기간 : 2025년 10월 22일(수)~24(금)
- ▶ 규모 : 230개사 650부스
- ▶ 관람 : 54,119 명
- ▶ 주관 : 한국반도체산업협회
- ▶ 후원 : 삼성전자, SK하이닉스, 램리서치,
어플라이드 머티리얼즈, 시놉시스, KOTRA



- 스마트폰, TV 등 반도체 수요제품부터 메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서등 반도체 산업 **생태계** **소분야가 참여**
- 전시회 참가기업 상호 간 공급/수요기업이 되는 **산업 생태계형 전시회**로 전시기간동안 홍보·비즈니스의장으로 활용가능
- 캐나다, 영국, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공
- **동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)**과 더불어 개최되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술 정보확보 및 홍보효과 기대

2. SEDEX 2025 Review

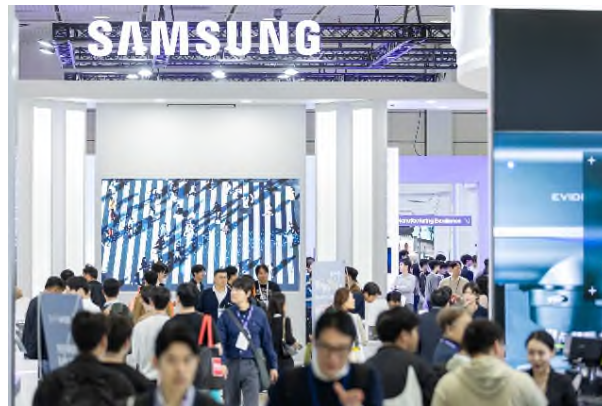


SEDEX Keynote

- ✓ 개막일인 22일(수)에 ▲삼성전자 송재혁 CTO가 ‘시너지를 통한 반도체 혁신’을, ▲중앙대학교 성윤모 석좌교수(前 산업통상자원부 장관)가 ‘반도체산업 패권경쟁 동향 및 정책제언’을, 그리고 ▲엠코테크놀로지코리아 이진안 대표가 ‘반도체 생태계에서의 첨단 패키징 리더십’을 주제로 AI 시대 반도체 산업의 청사진을 제시했다.
- ✓ 삼성전자 반도체(DS) 최고기술책임자(CTO) 송재혁 사장은 은 기조연설에서 “과거와는 다르게 현재는 공통 기술 플랫폼을 기반으로 한 ‘통합형 팀 운영’이 가능해졌다”며, 이를 통해 내부 기술 간 시너지와 효율성을 극대화하고 있음을 강조했다.
- ✓ 이진안 엠코테크놀로지코리아 대표는 기조연설에서 패키징의 본질적 가치로 “칩 간 거리를 최소화해 신호 지연을 줄이고, 데이터 전송 속도를 극대화할 수 있는 기술력”을 꼽았다.
- ✓ 중앙대학교 성윤모 석좌교수는 “글로벌 반도체 공급망은 기술 중심에서 전략 자산 중심의 경쟁 구도로 전환되고 있으며, 첨단 패키징은 그 중심에 있다”고 분석했다. 그는 미국과 유럽의 반도체 산업 정책을 언급하며, 한국이 경쟁력을 유지하기 위해서는 AI 반도체·첨단 패키징·소부장 연계 생태계 강화가 필요하다고 강조했다.



- ✓ 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 이번 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보였다. ▲ **엑시콘, 와이씨, 썬씨엔에스**은 AI 확산에 따라 차세대 메모리로 주목받는 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 칩셋의 검사 장비를 선보였다. ▲ **신성이엔지**는 습도 감지 센서와 자동 제어 시스템으로 팹 내 공기 중 수분을 제거하고 일정한 습도를 유지하는 제습 기능을 더한 차세대 장비로 업계의 관심을 모았다. ▲ 국내 대표 장비 기업인 **주성엔지니어링**과 **원익IPS**, **케이씨텍**도 참가하여 차세대 반도체 미세공정 기술력을 선보였다. ▲ **QRT**는 고신뢰성 반도체 평가 솔루션을 중심으로 우주·국방용 칩의 SEE(단일사건오류) 분석 장비와 RF HTOL 분석 시스템을 전시하며 시험·평가 장비 시장에서의 차별화된 역량을 강조했다. ▲ **한미반도체**는 HBM4(6세대 HBM) 생산용 신규 장비인 'TC 본더 4'를 비롯해 인공지능(AI) 로직 반도체에 사용되는 '2.5D 빅다이 TC 본더'와 '빅다이 FC 본더' 등도 국내 전시회에서 처음으로 소개했다.





✓ ▲ **동진세미켐**은 하이브리드 본딩(HCB)용 화학기계적 연마(CMP) 슬러리(Slurry) 기술을 선보였다. ▲ **미코, 코미코, 미코세라믹스**는 HBM 공정용 TSV TC Bonder에 적용되는 세라믹 ‘펄스 히터’를 소개했다. ▲ **켄트로닉스**는 노광 공정에 사용되는 고순도 PGMEA 소재 및 친환경 공정 화학소재 기술을 공개하며, 소재-가공-패키징을 아우르는 통합 포트폴리오를 소개했다. ▲ **에이직랜드**는 맞춤형 SoC/ASIC 설계 자동화 플랫폼 3종을 발표하며, 스타트업 및 팹리스 대상 클라우드 기반 설계지원 서비스로 설계 생산성 혁신을 제시했다. ▲ **세미파이브**는 이번 전시회에서 데이터센터부터 스마트 글래스까지 AI 응용 분야 전체를 아우르는 설계 포트폴리오를 선보이며 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 모빌린트 등 국내 AI 팹리스와 협업한 성과를 중심으로, 엑시나, 한화비전넥스트, 에티포스, 사피엔반도체 등 디바이스 제조사(OEM)와 함께 구축한 설계 포트폴리오도 공개했다.





✓ 이번 전시회에서는 전년 대비 지방자치단체의 참여가 한층 활발해졌다. ▲ 충청북도, ▲ 강원특별자치도, ▲ 인천광역시, ▲ 대전광역시, ▲ 용인특례시, ▲ 안성시, ▲ 이천시, ▲ 구미시, 등이 참가하여 반도체 및 IT 산업 관련 정책과 투자 유치 활동을 적극적으로 전개했다. 주요 공통점으로는 관내 기업과의 공동관 운영, 투자 인프라·세제 혜택 홍보, 특화 산업단지 및 클러스터 소개, 인재 양성 및 테스트베드 구축 전략 홍보 등이 있었다. 각 지역은 자치단체의 강점을 부각하며 투자 매력 제고와 네트워크 형성, 판로 개척 지원에 힘썼고, 이를 통해 지역 산업 발전과 반도체 생태계 활성화를 도모했다.



3. Floor Plan : 650 booths

SEDEX 2025

Hall D



Hall C



출구

4. Exhibitor List : 230 companies

업체명	부스 업체명	부스 업체명	부스 업체명	부스 업체명	부스 업체명	부스
반도체소부장 산업협력단	C039 (주)한국나노오트	C125 티지텍코리아	C308 두인에스제이테크	C422 (주)자원	C545 로움주식회사	D101
소부장 기술 융합 연구소 공동관	C801~C818 (주)나노시스템	C125 엠케이이 주식회사	C309 오엔엠힐리아드코리아 유한회사	C423 (주)자비스	C801 주식회사 세미솔루션	D105
시스템반도체 인프라 공동관	D001 (주)파네시아	C125 코아텍	C311 SMART DV Technologies	C424 (주)대성엔지니어링	C802 (주)엑시콘	D107
센서전력반도체공동관	D301 (주)동우텍	C125 세코아	C313 엔비케이	C425 서플루스글로벌	C803 주식회사 와이씨	D107
시스템반도체기업 공동관	D317 한국센서연구소(주)	C125 인큐솔루션	C315 (주)넷웍	C429 (주)에이치엘유믹스	C804 (주)생씨엔에스	D107
한국순수기술(주)	C001 (주)피코팩	C125 트루칩	C316 (주)세미로드	C431 (주)한조트몰	C806 차세대반도체 혁신융합대학	D113
한국지노(주)	C003 (주)헤시스	C125 일진디스플레이(주)	C317 (주)케이브이씨	C433 메타솔	C807 이천사청	D201
(주)가나	C005 엠에이엑스	C137 (주)영우디에스피	C319 한국전자기술연구원	C435 (주)하드렘	C808 용인특례시	D207
(주)스리에치코퍼레이션	C007 충청북도	C139 (주)하이센이노텍	C320 슈니베거코리아(유)	C437 (주)타마스케이플	C809 (주)지엔지인텍	D207
상생협력 홍보관	C009 캔엑스코리아(주)	C147 반도체펀드 Showcase	C321 코리아스펙트럼 프록덕츠(주)	C439 넥슨전자주식회사	C610 (주)에이치알테크	D207
한국표준과학연구원	C009 한미반도체	C149 한국기초과학 지원연구원	C323 (주)핀웍스	C441 넷싸이트	C611 (주)이큐글로벌	D207
(주)케미조아	C019 에버넌트코리아	C161 엑스피 파워	C324 무악안보관리원	C447 유림솔루션	C612 (주)신성아연지	D219
한국 나노마이스터 고등학교	C023 에이직랜드	C165 카사이테크놀로지스	C325 테크노헬즈코리아 주식회사	C501 이노에트리	C613 원익PS	D225
하이델베르크 인스트루먼트 코리아	C026 (주)인코비온	C201 케이엔에프뉴베르거	C327 주식회사 와이에스피	C502 (주)원에스티	C614 케이씨텍	D229
양산 인공지능 고등학교	C027 한국알박(주)	C203, C215 세미온 주식회사	C328 (주)다온오토메이션	C503 아큐레이저	C616 큐알티 주식회사	D233
주식회사 주원	C028	C215 충북반도체고등학교	C329	C507 프레스토솔루션	C617 서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터	D237
구미사청	C029 유니락(주)	C209 마이다스시스템 주식회사	C331 센세미글로벌	C507 캠퍼스	C618	D237
아마젠코리아	C036 (주)제471한국	C211 주식회사 다다	C333 브이디엠에탈즈코리아	C508 에드워드코리아(주)	C619 아이언디바이스	D301
(주)창산일렉트로닉	C038 몰라테크	C217 크라이오에이치엔아이	C337 (주)세스텍	C509 (주)트로보틱스	C620 제엠제코(주)	D301
뉴파워플라즈마	C039 (주)피에스텍	C218 (주)제이엔엘테크	C339 (주)라온솔루션	C511 (주)프로보	C701 (주)루트세미콘	D301
(주)엑시콘	C039 (주)아썬리드	C219 (주)에이케이씨	C341 (주)플랑크랩	C512 비엔코리아	C703 스카이칩스	D301
(주)원익큐엔씨	C039 한국기술교육대학교 RISE사업단	C220 (주)에스티아이	C345 고원	C513 (주)벨토사이언스	C704 (주)타스기술연구소	D301
(주)유진테크	C039 (주)큐박셀	C222 루미엔	C401 MDS테크	C514 한국자동차산업 협동조합	C705 (주)이엘티센서	D301
파크시스템스	C039 씨오아이 주식회사	C226 주식회사 인턴스	C403 대한무역투자진흥공사	C515 한국실장산업협회	C706 (주)센소허브	D301
카엑스코리아	C043 한국텍트로닉스	C228 고테스트	C404 플렉스코리아	C516 SEDEx 2026 부스신청라운지	C707 파워큐브세미(주)	D301
산업부 패키징 R&D	C045 강원특별자치도	C230 일드엔지니어링 시스템즈(주)	C405 브이웨이	C517 서플루스글로벌(주)	C709 (주)바움디자인시스템즈	D317
안성사청	C049 하이콘주식회사	C236 (주)제이엔엘테크	C405 오알오 주식회사	C518	C709 잇다반도체	D317
주식회사 크닉코리아	C057 케이에스티(주)	C238 (주)정기테크노파크	C407 주한영국대사관	C519 (주)보부하이테크	C710 (주)이씨엔씨	D317
차세대저능행반도체 기술개발사업	C067 (주)알레스랩	C242 윤스랩(주)	C409 티윈솔루션 주식회사	C523 주식회사 해치텍	C714 수퍼게이트(주)	D317
나노텔코리아	C101 (주)비엔비옴토	C247 (주)아엘코퍼레이션	C410 엠텍바전(주)	C524 세미파이버	C716 오픈엠티테크놀로지 주식회사	D317
비전텍	C103 삼일기계법인	C247 세움트로닉스	C411 (주)다원엔지니어링	C525 삼성전자	C800 (주)뉴링크테크놀로지	D317
(주)미코	C105 인천광역시	C248 (주)브릴위즈	C412 (주)에스와이	C526 시스템반도체 개발지원센터	D001 (주)필라티스반도체	D317
(주)미코세리믹스	C105 (유)스테츠칩팩코리아	C250 (주)에스에스테크놀로지	C413 플라스이엔지	C527 차세대융합기술연구원	D001 (주)칩스케이	D317
(주)코미코	C105 (주)엔도티엔씨	C250 주식회사 휴템	C414 세라텍	C528 한국기계전기전자 시험연구원	D001 주식회사 램업	D317
(주)쉴유인애듀	C113 (주)에스에스피	C250 코모브	C415 (주)서원오토메이션	C529 시스템반도체 설계지원센터 (KSIA)	D001 불루닷(주)	D317
KSIA 반도체 인력양성 프로그램 특별관	C115 (주)칩스	C250 이스탄글로벌/동호	C416 (주)엑스엠지	C532 동진세미켄	D001 칩스엔미디어	D317
기호알엔디(주)	C123 인천테크노파크	C250 CANADA's Semiconductor Council	C417 (주)GCT다이아몬드코팅	C534	D013 (주)에이프로세미콘	D317
대전테크노파크	C125 파이프케이(주)	C301 Xiphery Oy	C417 셀링크 주식회사	C536 리스광시스템(주)	D023 (주)버트리	D317
	C125 세일테크노	C303 REGAL JOINT	C420 (주)세기시스템	C538 씨케이이(한국)	D035 SK하이닉스	D400
		C307	C421 (주)켄트로닉스	C539	D039	

5. SEDEX 부대행사

Seminar Program

프로그램 총괄

10월 22일(수)

장소	시간	프로그램	주최
401호	14:00~15:20	SEDEX 2025 Keynote	한국반도체산업협회

10월 23일(목)

장소	시간	프로그램	주최
300호	10:00~12:00	반도체 공정·장비 지능화 세미나	한국반도체연구조합
301호	9:40~17:10	제 8회 반도체 산학연 교류 워크숍	한국반도체연구조합, 대한전자공학회
307호, 308호	9:10~17:10	ASCC(Asian Symposium on Contamination Control) 2025	한국공기청정협회
317호	14:00~16:30	반도체시장 전망 세미나	한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합
403호	11:00~12:00	이천시 투자유치 설명회	이천시청

10월 24일(금)

장소	시간	프로그램	주최
301호, 317호	10:00~16:50	제 8회 반도체 산학연 교류 워크숍	한국반도체연구조합, 대한전자공학회
307호, 308호	9:10~11:15	ASCC(Asian Symposium on Contamination Control) 2025	한국공기청정협회

SEDEX Insight Zone

SEDEX Insight zone

일시	2025. 10. 22(수) ~ 24(금)
장소	COEX C Hall SEDEX Insight zone(C600)
주관	한국반도체산업협회

10월 22일(수) - DAY 1

시간	프로그램	주관/연사
11:10~11:40	AI를 활용한 반도체 기업의 경쟁력 강화 방안	PwC컨설팅 정성문 파트너
14:00~16:00	반도체 양산성능평가 TECH-DAY	한국반도체산업협회

10월 23일(목) - DAY 2

시간	프로그램	주관/연사
10:30~11:00	반도체 전력 및 동적 전류 측정 기술 - 저전력 설계를 위한 핵심 인사이트	키사이트테크놀로지스 유창호 대리
11:10~11:40	트럼프 통상규제와 반도체 기업의 대응 전략 (관세와 수출 통제를 중심으로)	삼일회계법인 소주현 파트너
13:00~13:30	이천시 기업 성공 사례 발표	이천시청
13:40~14:10	TGV공정 미세결함 정밀검사 / X-Ray(3D CT) 비파괴 검사 솔루션	이노메트리 신진우 전무
14:20~14:50	마이크로/나노-스케일 발열특성 측정/분석 열영상 현미경 기술	한국기초과학지원연구원 장기수 책임연구원
15:00~15:30	SemiMarket: 레거시 반도체 장비 및 부품의 AI 마켓플레이스	서플러스글로벌 김정웅(Bruce Kim) CEO
15:40~16:10	고밀도 자동화 저장 시스템을 통한 반도체 산업의 경쟁력 강화	카텍스코리아 최준갑 영업이사
16:20~16:50	R&D : 한국이스라엘 반도체 기술협력 전략	한국이스라엘산업연구개발재단 최수명 책임연구원

10월 24일(금) - DAY 3

시간	프로그램	주관/연사
13:00~15:00	AI트렌드로 읽는 반도체산업 취업전략 세미나	한국반도체산업협회

6. SEDEX 언론기사

온/오프라인 뉴스, 전문지, 경제지, 블로그 등 270여회 노출

삼성전자·SK하이닉스, 반도체대전 HBM4 격돌

SEDEX 2025

올해 말 양산...실물 첫 공개

삼성전자와 SK하이닉스가 6세대 고대역폭메모리 'HBM4'로 맞붙었다. 양사는 22일 한국반도체산업협회 주최로 열린 '반도체대전(SEDEX 2025)'에서 HBM4를 전면에 내세웠다. 현재 공급하고 있는 HBM3E에 이은 차세대 제품으로, HBM4 실물이 일반에 공개된 건 이번이 처음이다. HBM4는 기존 고대역폭메모리(HBM)들과 달리 가장 밀집(배이스다

이)에 메모리 컨트롤러 등 시스템 반도체 기술이 적용된다. HBM 성능과 효율성을 끌어올리기 위한 것으로, 고객의 요구에 맞춰 컨트롤러 등이 추가·제작되기 때문에 '맞춤형 HBM' 시대 개막을 알리는 제품이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4 격돌을 예고하고 있다. SK하이닉스가 HBM 시장을 주도하고 있지만 삼성은 설계기술로 준비한 HBM4로 따라진 모습을 보여 주겠다는 각오다. 실제로 5세대 D램인 '1V'로 HBM4를 만든 SK하이닉스와 달리 삼성전자는 6세대 D램인 '1.2V'로 HBM4를 준비했

다. 추적자인 만큼 남과 똑같은 방식이 아니라 차별화된 기술로 HBM4를 만들어서 시장 판도를 흔들겠다는 의지이다. 삼성전자는 HBM4를 위해 1번이 되는 1e D램 설계를 전면 개선하는 등 경쟁력 확보에 집중했다. SK하이닉스는 자신감을 보이고 있다. 이날 전시 부스에서도 HBM을 중심으로 배치, 시장 리더십을 이어 가겠다는 의지를 보였다. SK하이닉스의 HBM4는 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC와 만들어 눈길을 끈다. 메모리 컨트롤러가 포함된 베이스 다이를 TSMC가

제조하고, SK하이닉스가 D램을 올려 HBM4를 완성한다. 시스템 반도체 제조 1위 TSMC와 HBM 1위 SK하이닉스가 협력해서 만든 제품이기 때문에 성능과 시장에 미칠 영향력이 상당할 것으로 예상된다. 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4를 올해 말 양산할 예정이다. 연비다이의 차기 인공지능(AI) 가속기인 루빈의 탑재가 목표다. 양산이 임박한 HBM4를 일반에 공개하는 건 기술에 대한 자신감과 시장 공략 의지가 반영된 것이다. 권동준기자 dikwon@etnews.com ▶관련기사 19·23면



제27회 반도체대전(SEDEX 2025)이 22일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 참가업체 삼성전자의 6세대 고대역폭 메모리 'HBM4'를 살펴보고 있다. 이은경기자 foto@etnews.com

[출처] 2025 SEDEX 세덱스 후기 : 네이버 블로그

[출처] [후기] 반도체대전 SEDEX 2025에 다녀오다|작성자 Jay

[출처] SEDEX 2025 방문 후기|작성자 현서

실생활에서 쓰이는 반도체와 기술을 파악할 수 있습니다.

아쉬운 건 램리서치가 참여하지 못했다는 점이지만, 삼성전자와 sk하이닉스가 있다는 점에 안도하면서 참여했습니다 😊

더 정밀해진 AI카메라·보청기... 中企 반도체 진화 한눈에

현장리포 제27회 반도체대전

국내의 280여개 기업 기술 전시 중기 부스, 대기업 못지않은 인파 운전자 시선 감지 AI카메라용 칩 국산기술로 만든 전력반도체 눈길

22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '제27회 반도체대전(SEDEX 2025)' 현장은 발 디딜 틈 없이 붐볐다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대기업 부스 앞에는 인공 지능(AI) 반도체의 미래를 확인하려는 관람객이 몰렸는데, 그 못지않게 펌리스(반도체 설계), 디자인하우스(반도체 설계 지원), 반도체 소재·부품·장비(소부장) 등 중견·중소기업 부스에도 관람객들의 발길이 이어졌다. 반도체 생태계를 지탱하는 이들은 대형 패널과 제품 설계도, 시연 영상 등을 선보이며 혁신 기술을 뽐냈다. 한국반도체산업협회에 따르면 이날 개막한 SEDEX 2025는 오는 24일까지 사흘간 열린다. 올해 전시 주제는 'Beyond Limits, Connected Innovation(한계를 넘어, 연결된 혁신)'으로 AI 시대를 맞아 반도체 산업의 설계·제조·후공정 간 유기적 연결을 강조했다. 현장에는 삼성전자·SK하이닉스를 비롯해 동진세미콘,



22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '제27회 반도체대전(SEDEX 2025)' D홀에 자리한 칩스미디어 부스.

서플라스코로보틱 등 국내외 280여개 기업이 700여개 부스를 마련했다. 기조강연에서는 △송재영 삼성전자 최고기술책임자(CTO) △성운모 전 산업통상자원부 장관(중앙대 석좌교수) △이진안 영고테크놀로지코리아 대표가 나섰다. 이들은 각각 반도체 혁신의 시너지, 산업 패권 경쟁, 첨단 패키징 리더십을 주제로 연설했다. 송 CTO는 발표에서 "모든 혁신은 결국 협업에서 비롯된다"며 반도체 기술 진화의 핵심으로 "경계를 넘는 협업"을 꼽았다. 그는 "한 명의 천재가 아닌 다양한 분야의 전문가들이 의견을 교류하고 시너지를 낼 때 진정한 혁신이 일어난다"며 "실리콘의 물리적 한계가 다가오는 만큼 소재·설비·패키징·테스트 등 전 분야의 융합이 필요하다"며 "삼성전자가 D램, 낸드, 로직, 패키징까지 보유한 유일한 기업으로서 내부 협업을 통해 새로운 시너지를 만들어가고 있다"고 강조했다. ■국산화·차입 기술로 반도체 생태계 저변 넓혀 C홀에 자리한 펌리스 중소기업 열대비



22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '제27회 반도체대전(SEDEX 2025)' C홀에 자리한 열대비전 부스. 사진=신지민 기자

전은 AI 카메라용 시스템반도체와 지능형 보청기를 집중 공개했다. AI 카메라용 칩은 차량 내부에서 운전자의 시선이나 졸음 상태를 실시간으로 감지해 안전운전을 돕는다. 열대비전 관계자는 "AI 카메라와 보청기 모두 혁신적 개선을 원하는 시장의 요구가 있었다"며 "아직 활성화되지 않은 시장에서 기회부터 선제, 사용까지 전 과정을 책임지는 통합 솔루션을 제공하면 의미 있는 성과가 나올 것"이라고 말했다. D홀에 위치한 칩스미디어는 국산 기술로 개발한 650V 집화갑질(GaN) 전력반도체 4종을 선보였다. '실리콘 기반 집화갑

질(GaN-on-Si)' 기술을 적용한 이 제품은 고속 모바일 충전기, AI 데이터센터, 산업용 전원장치 등에 사용된다. 칩스미디어는 비디오 설계자산(IP) 기술을 공개했다. 이는 반도체 안에 들어가는 기술 가운데 영상 압축·복원하는 기능을 한다. 칩스미디어는 비디오 IP를 처음 공급하며 받는 라이선스 및 이를 활용한 반도체가 판매될 때 발생하는 로열티가 양대 수입원이다. 설계 전문기업의 성장을 뒷받침하는 디자인하우스들도 대거 참가했다. 세미솔루션, 세미파인브, 에이직랜드, 펄라스반도체 등이 대표적이다. 이들 기업은 펌리스가 설계한 회로를 실제 반도체로 제작할 수 있도록 지원하는 맞춤형 주문형 반도체(ASIC) 서비스를 제공한다. 현장에는 한국노마스터고등학교 등 반도체 마이스터고도 부스를 마련했다. 김경희 한국반도체산업협회 부회장은 "AI 시대가 반도체 기업에 요구하는 것은 어제의 정답을 반복하는 것이 아니라, 아무도 가보지 않은 새로운 길을 여는 혁신"이라며 "이번 SEDEX 2025는 끊임 없이 한계에 도전하는 우리 반도체 기업들의 치열한 혁신의 결과물"이라고 말했다. jmn@fnnews.com 신지민 권준호 기자

저는 반도체 소자를 공부하다보니 반도체 미세화에 따른 트랜지스터 구조의 변화가 굉장히 인상깊더라고요.

교재에서만 보던 것을 실제로 구현해 놓으니 학생으로서 최고의 교보재라 할 수 있죠.

SEDEX는 국내외 반도체 기업들이 최신 기술과 제품을 전시하는 국내 최대 규모의 반도체 박람회로, 소자부터 장비, 소재, 설계까지 반도체 산업 전반을 한눈에 볼 수 있는 자리입니다! 매년 가을 열리는 행사라 반도체 전공자나 업계 종사자라면 꼭 한 번은 가볼 만한 행사라고 생각합니다.

7. SEDEX 2026 참가신청

Beyond Limits, Connected Innovation
한계를 향한 도전과 혁신

제28회 반도체 대전
SEDEX 2026
2026.10.14.(수) ~ 10.16.(금)
COEX Hall C&D

반도체산업 생태계 전문가가 참가하는
국내유일의 반도체 전문 전시회

SEDEX은 반도체 장비, 소재, 부품, 설계, 재료, 설비기업 등 반도체 생태계를 구성하는
전문가 300여개 기업이 참여합니다. 매년 5만명 이상의 반도체 관계자가 참여하며,
참가사에게 다양한 비즈니스 기회를 제공하고 있습니다.

전시회 규모 확대
2025년 Hall C&D1 (700부스) ▶ 2026년 Hall C&D (850부스)

사전신청 접수안내

일자	신청규모 별 접수 시간	
	12:00 - 14:00	14:00 - 16:00
1일차 (10/22)	-	10부스 이상
2일차 (10/23)	9~8부스	5~4부스
3일차 (10/24)	3~2부스	1부스

사전신청 접수처
* 부스번호 C707 SEDEX 2026 사전부스 신청 라운지
* 사전신청 혜택 : 참가비 25% 할인

문의
☎ sedex@ksia.or.kr
🌐 sedex.org

Organizer KSIA 한국반도체산업협회
Sponsored By SAMSUNG SK 전자닉스 APPLIED MATERIALS Lam SYNOPSYS kotra

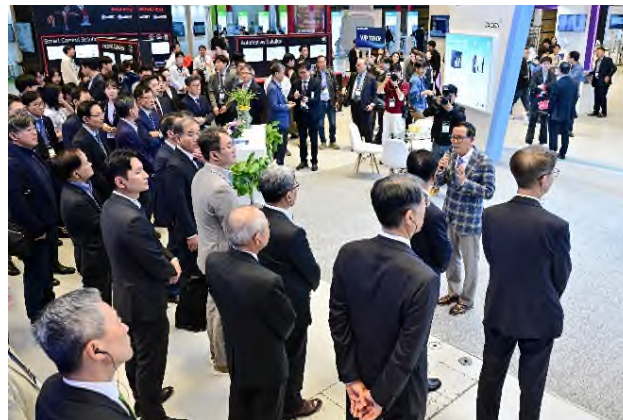
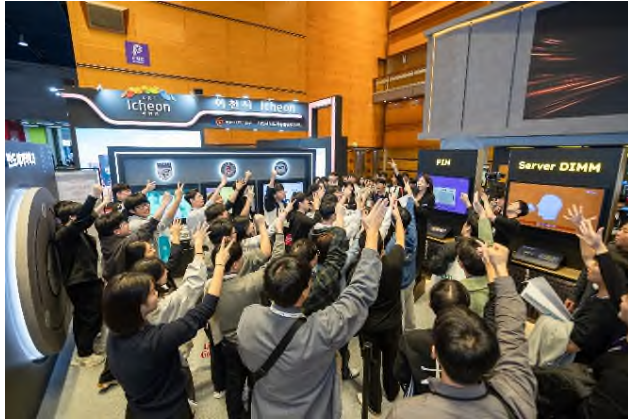
개최 개요

- 행사 : SEDEX 2026 (제 28회 반도체대전)
- 기간 : 2026년 10월 14일(수) ~16일(금), 3일간
- 장소 : 서울 삼성동 COEX Hall C&D (3F)
- 주관 : 한국반도체산업협회
- 참가사 : 메모리반도체, 시스템반도체, 소재부품장비 기업, 설비 센서 등 반도체 관련기업

참가신청

- 조기신청 할인
 - 1차 : ~2025. 12. 31 ➡ 15% discount
 - 2차 : ~2026. 4. 30 ➡ 10% discount
 - 3차 : ~2026. 6. 30 ➡ 5% discount
 - * 3년(2024년~2026년) 연속 참가기업 추가할인 5%
 - * 부스 소진 시 조기 마감

8. SEDEX Photo Gallery



감사합니다